

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 1 区分
【発行日】令和 3 年 9 月 2 日 (2021.9.2)

【公開番号】特開 2019-29346 (P2019-29346A)
【公開日】平成 31 年 2 月 21 日 (2019.2.21)
【年通号数】公開・登録公報 2019-007
【出願番号】特願 2018-138106 (P2018-138106)
【国際特許分類】

H 0 5 B 3/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

H 0 5 H 1/46 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 3/00 3 1 0 A

H 0 1 L 21/68 N

H 0 5 H 1/46 L

【手続補正書】
【提出日】令和 3 年 7 月 26 日 (2021.7.26)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 3 2
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 3 2】

基板支持体 1 0 6 は、エッジリング 1 8 0 を備える。エッジリング 1 8 0 は、上部リングに対応してよく、上部リングは、底部リング 1 8 4 によって支持されてよい。エッジリング 1 8 0 は、1 または複数の加熱素子 1 8 8 を備えてよい。したがって、温度コントローラ 1 4 2 は、セラミック層 1 1 2 の加熱素子 1 8 8 およびエッジリング 1 8 0 の加熱素子 1 8 8 の両方に供給される電力を制御してよい。本開示の原理に従った基板処理システム 1 0 0 において、温度コントローラ 1 4 2 は、後に詳述するように、（例えば、図 1 では図示していない共通フィルタモジュールと、電力供給ケーブル 1 9 2 とを含む）共有ケーブル・フィルタシステムを介して加熱素子 1 4 4 および 1 8 8 に電力を供給する。